

# EPEH-2520高延伸率低粘度环氧固化剂低放热，灌封，裂缝修补

产品名称	EPEH-2520高延伸率低粘度环氧固化剂低放热，灌封，裂缝修补
公司名称	络合高新材料（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LOHO 型号:2520 产地:上海
公司地址	浦东新区金沪路1160号A栋5楼
联系电话	13641734574

## 产品详情

LepmodEPEH-2520 高延伸率固化剂EPEH-2520 高延伸率低粘度环氧固化剂低放热，灌封，裂缝修补，与普通环氧配合（EEW=190g/eq），若配合其他柔性环氧，会获得更高的断裂延伸率。对金属及混凝土等具有极好的附着力、耐磨性以及抗撕裂性。应用场景为高韧性胶粘剂、复合材料、灌封等。

指标:

凝胶时间120min

EPEH-2520 为我司定制开发的一款具有良好柔韧性的高延伸率环氧固化剂

Lepcu^DICY固化促进剂

品名 挥发物 Max, % 熔点 °C 粒径 pm 添加量

PHR 典型特点 品牌

HUA 5020 1.0 160 ± 10 5 (D50) 1-5 DICY取代脲促进剂

HUA 5050 1.0 180 ± 10 5 (D50) 1-5 DICY低温取代脲促进剂 LOHO

HUA 5200 1.0 225 ± 10 5 (D50) 1-5 DICY取代脲促进剂，储存周期长

HUA 3500 1.0 200 ± 10 5 (D50) 1-5 DICY取代脲促进剂，储存周期超长，高温快固

## Lepcu芳香胺固化剂

熔点(°C) 含量, min 粒径,  $\mu$ m 典型特点 品牌

HSA-880 176-185 99 200-250 4,4-二氨基二苯基砵, 预浸料, 复合材料, 印刷电路板(PCB)、粉末涂料和电子模塑化合物(EMC) ATUL

HSA-660 167-175 99 200-250 3,3-二氨基二苯基砵, 预浸料, 复合材料, 印刷电路板(PCB)、粉末涂料和电子模塑化合物(EMC)

HSA-880S 175-185 99 10 (D50) 超细型4,4-DDS,易分散, 预浸料, 复合材料, 印刷电路板(PCB)、粉末涂料和电子模塑化合物(EMC) LOHO

HSA-660S 165-175 99 10 (D50) 超细型3,3-DDS,易分散, 预浸料, 复合材料, 印刷电路板(PCB)、粉末涂料和电子模塑化合物(EMC)

## Lepcu聚硫醇固化剂

粘度

(cps/25 °C) 色泽 Pt-Co 硫基含量

%,m/m PHR

(EEW190) 使用时间

1g/25 °C 典型特点 品牌

HM-800 10000-15000 <30 11-14 80-100 3-5min 低气味, 低温快固, 薄层固化 LOHO

HM-400 300-700 <30 25-27 62 — 良好的储存稳定性, 光学透明, 高折射率, 改善树脂耐冲击性能光固涂料, 感光材料

## Lepcu改性胺固化剂

品名 粘度 (cps/25 °C) AHEW PHR

(EEW:190) 使用时间 100g/25 °C 性能概述 用途 品牌

EPEH-2588 4000-12000 256 100: 135 40min 高延伸率, 高韧性, 高强度 电子电气灌封, 复合材料, 耐冲击胶粘剂

EPEH-2510 5000-8000 230 100: 120 130min 高延伸率, 低放热, 高粘结 塑料粘接, 铝材粘接, 灌封型糊剂 LOHO

EPEH-2520 100-500 105 100: 50 120min 低粘度, 低放热, 高粘结 电子电气灌封, 裂缝修补

应用领域: 高韧性胶粘剂, 桥面粘接, 复核材料, 灌封 包装: 20kg/桶